

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ZTE中兴

ZTE CORPORATION

中興通訊股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 763)

董事會公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、中興通訊股份有限公司（以下簡稱“本公司”）與美國高通公司（Qualcomm Incorporated）簽訂芯片採購框架協議

1、基本情況介紹

本公司近期隨中國機電貿易投資合作促進團訪問美國，根據本公司經營計劃，本公司2012年2月17日（太平洋時間(PST)）與美國高通公司簽署了《2012年-2015年芯片採購框架協議》（以下簡稱“《高通芯片採購框架協議》”）。根據《高通芯片採購框架協議》，本公司在2012年至2015年期間擬向美國高通公司的採購價值總計不少於40億美元。該事項屬於本公司正常的原材料採購行為。

2、美國高通公司介紹

美國高通公司總部設於美國加利福尼亞州，是CDMA(碼分多址)數字無線技術的先驅，也是推動3G無線產品和服務發展的領導廠商之一。美國高通公司在開發CDMA2000、1X、1xEV-DO和WCDMA(UMTS)芯片組和解決方案方面走在世界前列，同時將其核心CDMA專利技術授權給全球多家通信設備廠商。

3、風險提示

(1) 本公司與美國高通公司本次簽署的《高通芯片採購框架協議》是就協議雙方合作意圖所作的闡述，不對任何一方構成約束，也不會在協議雙方之間設定任何法律權利或義務。

(2) 本公司與美國高通公司雙方之間任何確定的交易應以雙方簽訂的長期供貨合同和具體訂單為準，本公司將根據生產經營情況逐步進行採購，實際執行情況可能與

該《高通芯片採購框架協議》存在偏差。

二、本公司與美國博通公司（Broadcom Corporation）簽訂芯片採購框架協議

1.基本情況介紹

本公司近期隨中國機電貿易投資合作促進團訪問美國，根據本公司經營計劃，本公司2012年2月17日（太平洋時間（PST））與美國博通公司簽署了《2012年-2014年芯片採購框架協議》（以下簡稱“《博通芯片採購框架協議》”）。根據《博通芯片採購框架協議》，本公司在2012年至2014年期間擬向美國博通公司的採購價值總計不少於10億美元。該事項屬於本公司正常的原材料採購行為。

2.美國博通公司介紹

美國博通公司總部設於美國加利福尼亞州，是全球領先的有線和無線通信半導體公司。美國博通公司產品在家庭、辦公室和移動環境中無縫提供語音、視頻、數據和多媒體連接。

3.風險提示

（1）本公司與美國博通公司本次簽署的《博通芯片採購框架協議》是就協議雙方合作意圖所作的闡述，不對任何一方構成約束，也不會在協議雙方之間設定任何法律權利或義務。

（2）本公司與美國博通公司雙方之間任何確定的交易應以雙方簽訂的長期供貨合同和具體訂單為準，本公司將根據生產經營情況逐步進行採購，實際執行情況可能與該《博通芯片採購框架協議》存在偏差。

承董事會命
侯為貴
董事長

深圳，中國

二零一二年二月二十日

於本通告日期，本公司董事會包括三位執行董事：史立榮、殷一民、何士友；五位非執行董事：侯為貴、謝偉良、王占臣、張俊超、董聯波；以及五位獨立非執行董事：曲曉輝、魏煒、陳乃蔚、談振輝、石義德。